

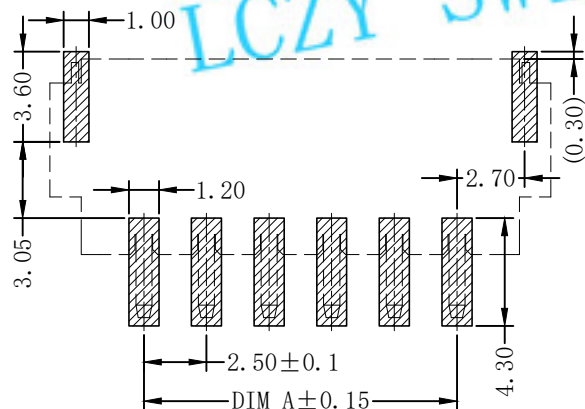
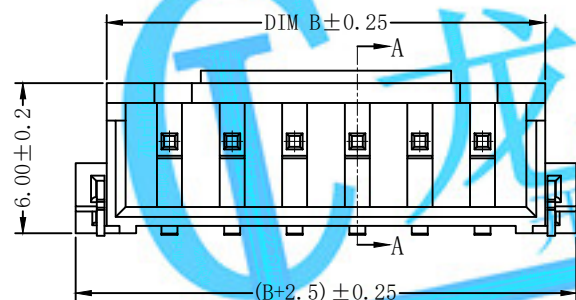
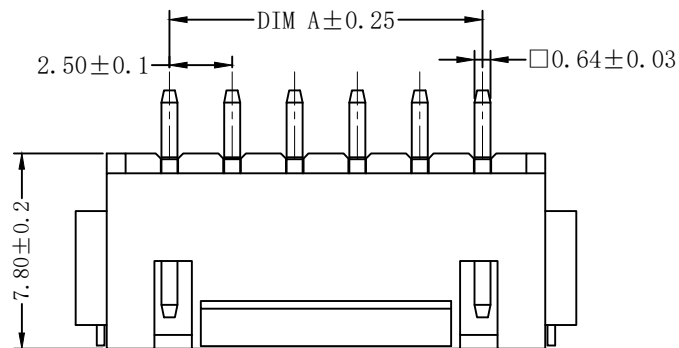
借用登记

旧底图总号

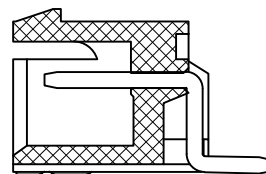
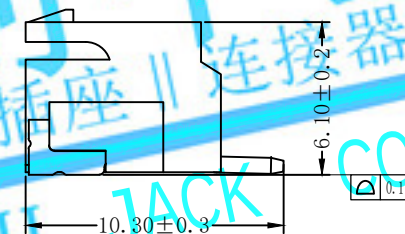
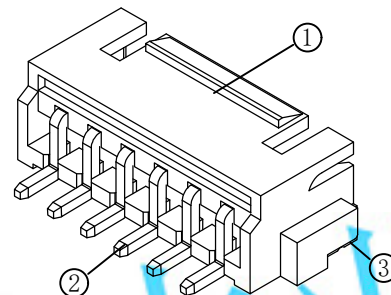
底图总号

签字

日期



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



SECTION A-A

技术要求:

- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 3.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim+105^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 260^{+5}_{-0} , 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

XHB-2.54-XP-WT-DK

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
...	...	...
20	47.50	52.50

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u"MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u"MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY		龙创中业电子科技(东莞)有限公司			
0.X	±0.25	X.°	±3°	CHK. BY					
0.XX	±0.12			APRV. BY		SHEET		PROD. NAME	
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°						
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.		1 OF 1		PART NO. XHB-2.54-XP-WT-DK	
MM	A4	1:1		006-0082-001		TITLE 2.00 FPC CONN. ZIF SMT FRONTFLIP H=2.0 DOUBLE LOWER CONTACT			